

债券代码：196022.SH

196261.SH

194099.SH

194244.SH

194360.SH

2280250.IB/184422.SH

2280412.IB/184580.SH

254595.SH

债券简称：21 金桥 04

22 金桥 01

22 金桥 02

22 金桥 03

22 金桥 04

22 金桥债 01

22 金桥债 02

24 金桥 02

上海金桥（集团）有限公司关于新增借款的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、新增借款概述

截至 2024 年 11 月 30 日，公司发生单笔新增借款超过 2023 年末净资产 20%的情形，具体借款情况如下：

单位：亿元

序号	借款主体	借款金额	担保措施
1	上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司	56.00	抵押保证担保

二、借款协议情况

上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司成立于 2002 年 5 月 16 日，注册资本为人民币 296,803.58 万元，公司法定代表人为周尧。截至 2023 年末，上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司资产规模为 50.89 亿元，净资产为 28.37 亿元，2023 年度实现营业总收入 0.75 亿元，实现净利润-0.05 亿元。

上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司与国家开发银行上海市分行签署《人民币资金借款合同》，合同总金额为人民

币 56.00 亿元，借款用途为用于金谷智能终端制造基地 WK14-4 地块项目建设，借款期限为 25 年，为抵押保证担保。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计提款上述借款 0.91 亿元。

三、相关决策情况

上述借款已经过公司内部决策程序审批通过，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

四、影响分析和应对措施

因公司日常经营和业务发展需要，2024 年度增加银行借款融资。上述新增借款主要用于金谷智能终端制造基地 WK14-4 地块项目建设，上述借款对公司日常经营、偿债能力等无重大影响。

特此公告。

（本页无正文，为《上海金桥（集团）有限公司关于新增借款的公告》之盖章页）



上海金桥（集团）有限公司

2024 年 12 月 10 日